

# 有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

**保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股187,143,158股普通股，占公司发行后总股本的比例为15.00%。本次发行初始战略配售数量为56,142,947股，占本次发行数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为104,800,211股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为26,200,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2022年10月31日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人：**有研半导体硅材料股份公司

**保荐机构（主承销商）：**中信证券股份有限公司

2022年10月28日

（此页无正文，为《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：有研半导体硅材料股份公司



2022 年 10 月 28 日

（此页无正文，为《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上  
市网上路演公告》盖章页）



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022 年 10 月 28 日